

吉林华微电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司吉林麦吉柯半导体有限公司（以下简称“麦吉柯”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为麦吉柯共计担保本金金额为人民币5,700万元。截至本公告披露日，公司本年度已实际为麦吉柯提供的担保余额为人民币18,910万元（担保余额数据不含本次）。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计金额：无。

一、交易及担保情况概述

（一）本次担保基本情况

近日，公司与兴业银行股份有限公司吉林分行（以下简称“兴业银行吉林分行”）签署了《最高额保证合同》，为麦吉柯提供债权金额人民币5,700万元的连带责任保证担保。

（二）审议程序

公司于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十二次会议，于2024年6月11日召开了公司2023年年度股东大会，审议并通过了《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案，同意控股子公司向相关商业银行贷款并与其签署相关协议，公司在授权期限内为控股子公司提供总额度不超过350,000,000.00元的担保。前述新增担保总额度授权有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。具体详见公司披露的《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-007）

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关文件的规定，本次担保均在预计额度内，无需单独提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

● 吉林麦吉柯半导体有限公司

统一社会信用代码：91220214764574610L

成立时间：2004年9月7日

注册地址：吉林高新区深圳街99号

法定代表人：李斌晖

注册资本：人民币7,000万元

经营范围：半导体分立器件、集成电路、电力电子器件、汽车电子器件、电子元件、LED产品的设计、开发、制造与销售；计算机及软件、电子产品及其他通信设备的研发、生产、销售及技术服务；技术进出口、贸易进出口（国家法律、法规禁止、限制的进出口商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司直接持有麦吉柯100%的股权，麦吉柯为公司下属全资子公司。

麦吉柯不是失信被执行人。

被担保人最近一年又一期主要财务指标

（单位：万元）

主要财务指标	2023年12月31日 （经审计）	2024年9月30日 （未经审计）
资产总额	67,420.99	57,820.56
总负债	32,152.05	30,478.54
净资产	35,268.94	27,342.02
	2023年度 （经审计）	2024年1-9月 （未经审计）
营业收入	34,562.14	25,979.63
净利润	1,508.44	1,775.01

三、合同的主要内容

（一）公司与兴业银行吉林分行签署的《最高额保证合同》

保证人（甲方）：吉林华微电子股份有限公司

债权人（乙方）：兴业银行股份有限公司吉林分行

债务人：吉林麦吉柯半导体有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：1、本合同所担保的债权(以下称“被担保债权”)为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；2、本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。

3、在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。

4、债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。

5、为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出(包括但不限于律师费用、诉讼(仲裁)费、向公证机构申请出具执行证书的费用等)均构成被担保债权的一部分。

保证期间：1、保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言、保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年；2、如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年；3、如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年；4、如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年；5、若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：所保证的债权金额为人民币五千柒佰万元。

四、 董事会意见

上述担保是为满足公司全资子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，吉林麦吉柯经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

经2023年年度股东大会审议通过的对子公司提供的担保总额不超过人民币35,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的10.73%；截至2025年1月21日，公司及子公司对外担保总额为人民币25,100.00万元，占公司最近一期经审计净资产的7.69%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2025年1月22日